

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）根据战略发展规划，综合考虑公司未来核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等实际情况，经管理层研究，现对核心技术人员进行调整。新增丛海、陶珩、姜勇、陈煌琳、刘志强、何伟业为公司核心技术人员，原核心技术人员杜志游、麦仕义、李天笑因工作职责调整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职。
- 公司一直十分重视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，研发团队结构完整。核心技术人员职务调整不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、研发技术及持续经营能力产生实质性影响。
- 公司本次新增认定核心技术人员，有助于公司各项研发项目有序高效推进，并支持公司未来核心产品的技术升级，推动公司多产品布局的战略实现。

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）调整核心技术人员的状况

因工作调整，原核心技术人员杜志游、麦仕义、李天笑将不再参与公司核心

技术的研发，故不再认定其为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职。

1、核心技术人员的具体情况

杜志游博士，1959年生，美国国籍，上海交通大学学士，美国麻省理工学院硕士、博士。1990年至1999年，历任PraxairInc. 高级工程师、经理、董事总经理等；1999年至2001年，担任应用材料全球供应管理经理；2001年至2004年，担任梅特勒-托利多上海子公司总经理；2004年至今，历任中微公司副总裁、资深副总裁、首席运营官、副总经理。截至本公告披露日，杜志游先生直接持股1,398,326股，所持股份合计占公司总股本0.23%。

麦仕义博士，1947年生，美国国籍，台湾大学学士、美国马里兰大学博士。1985年至1989年，担任英特尔资深工程师；1989年至2003年，担任应用材料资深总监；2004年1月至2004年6月，担任英特尔项目经理；2004年8月至2020年3月，任中微公司副总裁。截至本公告披露日，麦仕义先生直接持股1,851,326股，所持股份合计占公司总股本0.30%。

李天笑先生，1958年生，美国国籍，复旦大学学士、美国韦恩大学硕士、美国纽约大学硕士。1990年至1995年，担任美国索尼资深电气工程师；1995年至2004年，担任应用材料亚太项目经理；2004年9月至今，任中微公司副总裁。截至本公告披露日，李天笑先生直接持股1,663,782股，所持股份合计占公司总股本0.27%。

2、参与研发项目和专利情况

杜志游先生在任职期内，参与研究并作为第一发明人获得知识产权共40项；麦仕义先生在任职期内，参与研究并作为第一发明人获得知识产权共2项；李天笑先生在任职期内，参与研究并作为第一发明人获得知识产权共2项。

公司享有前述知识产权的所有权，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在

纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司与杜志游、麦仕义、李天笑签署分别签署了《保密协议》及《雇员保密信息和发明协议》，对各方的权利义务进行了约定。截至本公告披露日，公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。

（二）新增核心技术人员的状况

因相关人员工作调整，公司新增认定丛海、陶珩、姜勇、陈煌琳、刘志强、何伟业为公司核心技术人员。上述人员简历及持有公司股份情况如下：

丛海先生，1967年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学硕士研究生。1995年至2002年，担任新加坡特许半导体蚀刻资深工程师；2002年至2003年，担任美国台积电海外厂蚀刻资深工程师；2003年至2018年，担任新加坡GlobalFoundries研发部门蚀刻部技术总监；2020年加入中微公司，现任中微公司董事、副总裁、刻蚀产品部总经理。截止公告披露日，丛海先生通过Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia持有本公司股份36,841股，所持股份合计占公司总股本0.01%。

陶珩先生，1975年出生，中国国籍，上海交通大学硕士研究生。1997年至2002年，担任武汉理工大学校办工厂机械工程师；2002年至2003年担任捷锐气压设备（上海）有限公司机械工程师；2003年至2005年担任精机电（上海）有限公司机械工程师。2005加入中微公司，现任公司董事、集团副总裁、LPCVD产品部和公共平台工程部总经理。截止公告披露日，陶珩先生通过嘉兴创微企业管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份133,570股，所持股份合计占公司总股本0.02%。

姜勇先生，1974 年出生，中国国籍，上海交通大学工学学士，上海交通大学工学硕士。2005 年加入中微公司，现任中微公司副总裁、MOCVD 产品部副总经理。截止公告披露日，姜勇先生直接持有本公司股份 2,790 股，通过嘉兴创微企业管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 142,011 股，所持股份合计占公司总股本 0.02%。

陈煌琳先生，1970 年出生，中国台湾籍，台湾工业技术学院学士。2000 年至 2018 年，就职于泛林半导体，任职资深客户服务经理；2018 年加入中微公司，现任中微公司副总裁、ICP 产品部总经理。截止公告披露日，陈煌琳先生直接持有本公司股份 2,030 股，通过 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia 持有中微公司股份 58,284 股，所持股份合计占公司总股本 0.01%。

刘志强先生，1977 年出生，新加坡国籍，北京清华大学学士，硕士。2002 年至 2004 年，就职于中芯国际集成电路制造有限公司，担任蚀刻工艺工程师；2004 年至 2008 年，担任新加坡特许半导体蚀刻主任工程师。2008 年加入中微公司，现任中微公司副总裁、CCP 刻蚀部总经理。截止公告披露日，刘志强先生未直接或间接持有本公司股份。

何伟业先生，1982 年出生，中国国籍，南京大学学士，硕士。2007 年至 2010 年，就职于中芯国际逻辑技术研发部，担任工艺工程师；2011 年至 2021 年，就职于应用材料（中国）有限公司，历任技术主管、产品经理；2021 年加入中微公司，现任中微 LPCVD 产品部总经理。截止公告披露日，何伟业先生未直接或间接持有本公司股份。

（三）调整后核心技术人员的状况

截至本公告披露日，公司核心技术人员共 9 人。本次调整前后核心技术人员具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	尹志尧、杜志游、倪图强、麦仕义、杨伟、李天笑
本次调整后	尹志尧、倪图强、杨伟、丛海、陶珩、姜勇、陈煌琳、刘志强、何伟业

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED 生产、MEMS 制造以及其他微观工艺的高端设备领域。公司通过长期技术积累和发展，已建立了结构完整的研发体系，培养了有奋斗精神和协同创新能力的研发团队。本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷的情形，不会对公司的技术优势和核心竞争力产生不利影响，亦不影响产品研发和市场拓展进度。

公司一直十分重视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，研发团队结构完整。核心技术人员职务调整不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、研发技术及持续经营能力产生实质性影响。

公司本次新增认定核心技术人员，有助于公司各项研发项目有序高效推进，并支持公司未来核心产品的技术升级，推动公司多产品布局的战略实现。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，相关核心技术人员的工作交接已经完成，公司现有各项研发项目有序推进。公司高度重视新技术和新产品的持续创新，始终将技术和研发视作保持公司竞争力的重要保障，公司在业务发展过程中将持续加大研发投入，同时不断完善研发体系和团队的建设，提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司研发团队结构完整，研发团队及核心技术人员

总体稳定，公司的研发项目处于正常有序推进状态，本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2023年8月25日